コリメートされたビーム による転位観察

山口博隆、松畑洋文 産業技術総合研究所

2011年6月8日水曜日

4H-SiC

パワーエレクトロニクス材料として実用化研究が 進められているワイドギャップ半導体

シリコンの物性限界を超えた 高効率・省エネルギー化へ

パワーエレクトロニクス
電力の変換と制御を高速に効率よくおこなうため
のエレクトロニクス

半導体の物性値 (室温)

	物質		Si	GaAs	SiC			GaN	Diamond
					3C	6H	4H	Gain	Diamond
	バンドギャップ	ベンドギャップ (eV)		I.428	2.20	2.86	3.02	3.39	5.47
	遷移型		ID	D	ID	ID	ID	D	ID
	結晶構造		Diamond	ZB	ZB	Hex.	Hex.	WZ	Diamond
	熱伝導度 (Wc/mK)		1.51	0.54	4.9	4.9	4.9	1.3	20.9
	移動度 (cm²/Vs)	電子	1500	8500	800	460	1000	900	1800
		正孔	450	420	70	10	120	400	1600
	誘電率	ε(0)	11.9	12.91	9.72	9.66/10.03	9.66/10.03	9.5/10.4	5.93
		દ(∞)	11.6	11.10	6.52	6.52/6.70	6.52/6.70	5.35/5.35	5.76
	飽和ドリフト速度 (cm/s)		1×10 ⁷	2×10 ⁷	2.7x10 ⁷	2.0×10 ⁷	2.7×10 ⁷	2×10 ⁷	2×10 ⁷
	絶縁破壊電界 (MV/cm)		0.3	0.65	3.0	3.0	3.5	2.6	5.6
	真性半導体温度 (K)		600	850	1000	1300	I 400	2000	3000
	性能指数	Mj	I	19	730	400	990	550	2500
	高速・電力素子	Μκ	I	0.52	5.8	5.0	5.8	I.5	32
	高速・高集積素子	MRON	I	53	490	260	890	340	3900
	高耐圧素子	MHF	I	14	8.0	4.9	13	9.1	50
	高周波素子	5	· I					-	

2011年6月8日水曜日



結晶欠陥

多形、マイクロパイプ

転位、表面モフォロジー



素子の性能、信頼性





EL emission



X-ray topograph



Large Leak (LL)
Leak (L)
No leak (N)
Tanuma et al., 2008





SiC g = 0008



実験方法(ブラッグケース)







貫通らせん転位 **b** = ± [0001]



貫通らせん転位のひずみ場





$$\delta\theta = -\frac{1}{k\sin 2\theta_B} \frac{\partial(\boldsymbol{g}\cdot\boldsymbol{u})}{\partial x_g}$$
$$= -\frac{b}{2\pi} \frac{x}{x^2 + y^2}$$



実験方法(ラウエケース)



転位コントラスト





2011年6月8日水曜日



まとめ

- コリメートされたビームを使ったX線トポグラフィーによって、4H-SiCの転位を高分解能に観察した。
- ブラッグケース
 - ▶ 回折条件に応じた、転位のひずみコントラストが得られた。
 - ▶ 貫通らせん転位の断面像が得られた(ウィークビーム)。
 -) 貫通らせん転位のひずみ場の定量により、直接的にバーガースベクト ル b_sの符号が決定された(ウィークビーム)。
 - , ラウエケース
 - ▶ $\vec{b_s} \parallel [0001] \ \ \vec{g} \cdot \vec{b_s} = 0$ によって確認した。
 - ▶ 貫通らせん転位が刃状転位成分を併せ持つ混合転位があることを直接的に確認した: $\vec{b} = \vec{b_s} + \vec{b_e}$, $\vec{b_e} = (1/3) < 11\overline{2}0 >$
 -) 貫通らせん転位はウエハ表面に大きなひずみを誘起していることが わかった。